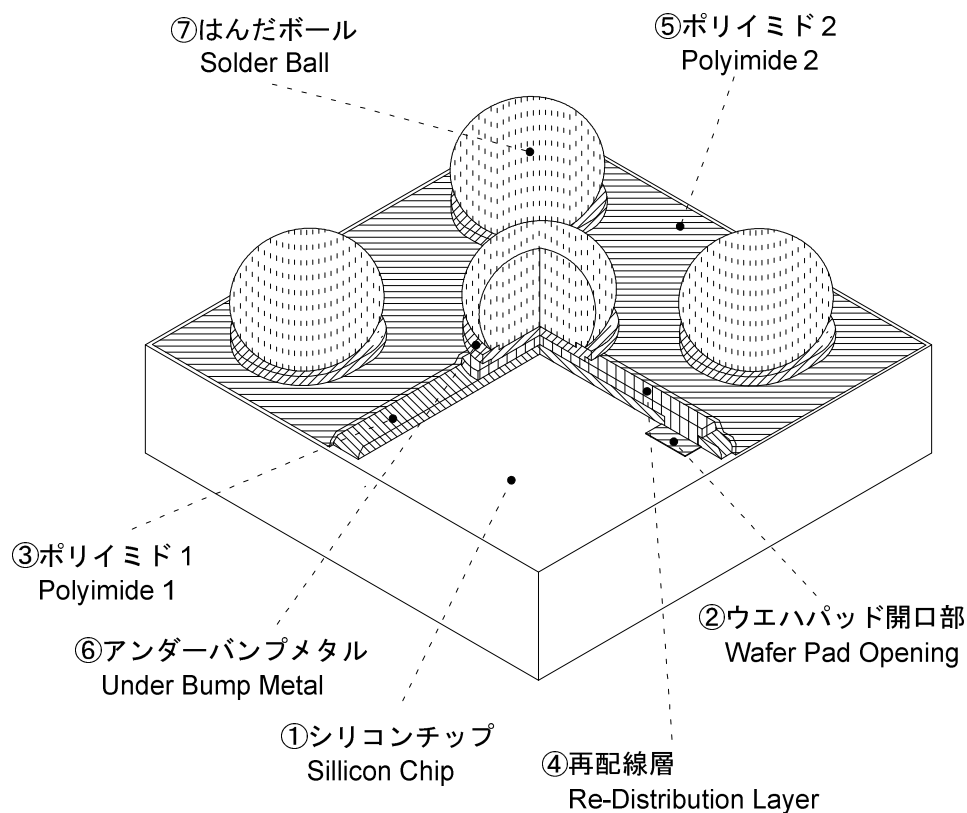


## WLP-5-03構造図

## WLP-5-03 Perspective

RoHS対応品  
RoHS Compliance



項目 Item	材料 Material	備考 Note
① シリコンチップ Silicon Chip	シリコン Silicon	
② ウエハパッド開口部 Wafer Pad Opening	アルミニウム Aluminium	
③ ポリイミド1 Polyimide 1	ポリイミド Polyimide	
④ 再配線層 Re-Distribution Layer	銅 + チタン Copper + Titanium	
⑤ ポリイミド2 Polyimide 2	ポリイミド Polyimide	
⑥ アンダーバンプメタル Under Bump Metal	銅 + チタン Copper + Titanium	
⑦ はんだボール Solder Ball	スズ + 銀 + 銅 Tin + Silver + Copper	

捺印表示 Marking	レーザー Laser marking
-----------------	-----------------------